

平成 21 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名：エルピーダメモリ株式会社  
（コード：6665 東証第一部）  
代表者名：代表取締役社長 坂本 幸雄  
問合せ先：執行役員 CFO 福田 岳弘  
（TEL：03-3281-1500）

### 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の 認定取得に関するお知らせ

当社は、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の事業再構築計画を経済産業省に提出していましたが、本日認定を受けましたのでご報告いたします。認定取得した事業再構築計画の内容は以下の通りです。

#### 記

- 1．認定を受けた年月日 平成 21 年 6 月 30 日
- 2．認定事業者名 エルピーダメモリ株式会社
- 3．認定事業再構築計画の目標

#### (1) 事業再構築に係る事業の目標

当社は、主にコンピュータやデジタル家電の一次記憶装置（メモリ）である DRAM の生産及び販売を行っているが、近年の DRAM 価格の急落により、大幅な赤字を計上し自己資本の毀損により経営が悪化している。背景には、マイクロソフト社が 2007 年 1 月に発売した新 OS 「ウィンドウズビスタ」によるパソコンの世界的需要拡大への期待や、2008 年 8 月に開催された北京オリンピックに伴う薄型テレビや次世代 DVD 装置等のデジタル家電の需要拡大の期待等から、DRAM メーカー各社は積極的な設備投資を行ってきたが、金融危機に端を発する世界経済の低迷により、パソコンや携帯電話等の需要が大幅に減少し、DRAM 価格が急落した。その結果、DRAM メーカー各社とも大幅な営業赤字が続いている。

中長期的には、DRAM 各社の減産効果により価格は持ち直す見通しであり、携帯電話、デジタル TV 向け等の高付加価値 DRAM（以下「プレミアム DRAM」という。）については、新興国の所得の増加等に伴い需要拡大が見込まれるものの、世界経済が厳しい状況においては、各社ともに大幅な事業見直しが必要である。この不況を乗り越えるべく、台湾やその他の地域においても経営統合を視野に入れた業界再編が進むと予想される。

プレミアム DRAM については、低電圧、低リーク電流などの当社の技術的優位性が付加価値を生む分野であり、当社は要求スペックの異なる多種多様な機器への需要に応えることができるため、高い競争力を有している。また、PC 向け等に用いられる汎用 DRAM については、PC 等で今後導入が進むと考えられる 64 bit OS（現在一般的に普及している OS より大

容量のメモリを扱うことができるもの)の普及により、PC一台あたりのメモリ搭載容量が増加することが予想されており、当社の強みである微細化技術を活かして、顧客からの大容量化、コストダウン要求に対応した商品設計を行いつつ、これを生産コストの安い台湾企業に生産委託することで、先行利益を獲得することが可能であると考えている。

このため、当社の強みである技術優位性を維持し、生産性を向上させ、シェアの更なる獲得につなげていくために、当社の強みであるプレミアムDRAMについて最先端の研究開発及び設備投資を行う。加えて、汎用DRAMについては、当社の強みである微細化技術を活かした商品設計を行いつつも、生産はコスト競争力のある台湾企業に委託する。

具体的には、今回の再構築計画の骨子は、大きく次の2つとする。まず、当社の広島工場を、より高付加価値かつ高生産性を実現できる最先端の設備を主とする工場へと転換させるために、財務基盤を強化し、研究開発投資資金と設備投資資金を確保する。次に、汎用DRAMの製造の主軸を台湾に移行させるために、台湾DRAMメーカーとの関係を構築・強化する。具体的には、現在、台湾当局主導により台湾DRAMメーカーを1つのDRAM企業(台湾メモリーカンパニー(仮称)(以下「TMC」という。)(平成21年度中に設立予定))に集約させる検討が進められているが、そのTMCとの連携を強化し、資本面での提携も視野に入れた関係を構築・強化する方向で協議・調整を行う。

なお、本計画は過剰供給構造の解消を阻害するものではない。

## (2) 生産性の向上を示す数値目標

生産性の向上としては、プレミアムDRAMについては広島工場に最先端の設備を導入することにより、また、汎用DRAMはその生産の主軸を台湾に移行することにより、有形固定資産回転率を平成23年度には平成20年度に比べて157%以上向上させることを目標とする。

## 4. 認定事業再構築計画に係る事業再構築の内容

### (1) 事業再構築に係る事業の内容

#### 中核的事業

プレミアムDRAMの開発、設計、製造、販売。

#### 選定理由

当社は、DRAM会社であり開発、設計、製造、販売まで、一貫した事業展開を行っているが、特に、開発、設計技術力では、世界においてもトップクラスに位置している。携帯電話やデジタルTV等の、高度な技術力を要求される高付加価値なプレミアムDRAM市場については、低電圧、低リーク電流などの当社の技術的優位性により、競合他社との差別化を保っていくことが可能である。また、プレミアムDRAMは顧客の要望に応じた仕様となるため、PC向け等に用いられる汎用DRAMに比べ利益率が高い。

#### 事業再構築に係る事業の内容

DRAM産業においては、プロセス技術開発において先行し、競合他社よりも小さいチップサイズ、低消費電力等を実現することが必要となる。

今回、株式会社日本政策投資銀行からの第三者割当増資を受ける。またTMCとの連携を強化し、資本面での提携も視野に入れた関係の構築を協議・調整する。これらによって財務基盤を強化し、研究開発投資及び設備投資資金の確保を行い、技術優位性を維持・強化する。

(事業の構造の変更：増資)

・増資

エルピーダメモリ株式会社は、第三者割当増資を行う。

第一次増資額：30,000,000,000円(内15,000,000,000円を資本金へ組入)

増資前資本金：158,665,024,242円

増資後の資本金：173,665,024,242円

増資の方法：株式会社日本政策投資銀行に対する第三者割当増資。

増資の予定日：平成21年8月(登記予定)

第二次増資額：200億円程度を想定。具体的内容については現在、協議・調整中。

増資の方法：TMCに対する第三者割当増資

増資の予定日：平成21年度中

(事業革新)

国内広島工場の最先端設備の月産ウェハー処理能力を、現状から大幅に増強することにより、顧客から強く望まれている高付加価値製品の安定的供給能力を確保する。

以上の設備投資を行うことにより、一枚から生産できる半導体チップ数量が大幅に増加し、製造原価は約20%削減可能となる。

(2) 事業再構築を行う場所の住所

東京都中央区八重洲二丁目2番1号

(3) 関係事業者又は外国関係法人

なし

(4) 事業再構築を実施するための措置の内容

別表1のとおり

5. 事業再構築の開始時期及び終了時期

開始時期：平成21年7月1日

終了時期：平成24年3月31日

6. 事業再構築に伴う労務に関する事項

(1) 事業再構築の開始時期の従業員数(平成21年3月末時点)

3089名

(2) 事業再構築の終了時期の従業員数(平成24年3月末)

3224名

(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数

3224名

(4) (3)中、新規に採用される従業員数

169名

(5) 事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数

出向予定人員数 なし  
 転籍予定人員数 なし  
 解雇予定人員数 なし

7. その他

当社の第11期定時株主総会（平成22年6月開催予定）において、平成21年3月31日現在の当社の資本準備金の額に150億円（株式会社日本政策投資銀行からの出資に際して計上される資本準備金の額に相当する金額）を合算した金額、又は、会社法第449条第1項第2号に定める欠損の額のいずれか低い金額を、減少する資本準備金の額として、資本準備金の減少を行う旨の議案を付議する。

別表

事業再構築の措置の内容

措置事項	実施する措置の内容及びその実施する時期	期待する支援措置
事業の構造の変更		
資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上	<p>第一次増資                      増資前資本金：158,665,024,242円                      増加する資本金：15,000,000,000円（資本準備金15,000,000,000円）                      増資の時期：平成21年8月（登記予定）                      増資の方法：株式会社日本政策投資銀行に対する第三者割当増資。</p> <p>第二次増資                      増資前資本金：173,665,024,242円                      増加する資本金及び資本準備金の合計額：200億円程度                      増資の時期：平成21年度中                      増資の方法：TMCに対する第三者割当増資。</p>	<p>租税特別措置法第80条（認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減）                      法第24条の2（株式会社日本政策金融公庫法の特例）</p>
事業革新		
第2条第4項第2号口	<p>国内広島工場の最先端設備の月産ウェハー処理能力を、現状から大幅に増強することにより、顧客から強く望まれている高付加価値製品の安定的供給能力を確保する。</p> <p>以上の設備投資を行うことにより、一枚から生産できる半導体チップ数量が大幅に増加し、最終製品コストは約20%削減可能となる。</p>	

以上